①特许出版公告

一許 公

昭52-40959

1 Int.Cl2 H 01 L 33 700/

識別記号 63日本分類

> 99(5) J 4 99(5) C 22

广内整理番号 7377-57

7738 -57

密公告 昭和52年(1977) 10 月 15

発明の数一」

(全 6 頁)

`1

図発光タイオード素子にけい光体を塗布する方法

创特 昭47-78868

砂田 昭47(1972)8月7日

公 昭49-37586

❷昭49(1974)4月8日

切発 者 長谷晃

H 01 L 23/02

鎌倉市台2の20の41大日本登

科株式会社大給要

同 十枝内秋男

茅ヶ崎市鶴ヶ台4の5の205

印出 顯 人 大日本連科株式会社

大阪市此花区西九条6の1の

124

砂代 理 人 并建士 山本茂 外1名

创特許請求の範囲

1 赤外発光性の発光ダイオード素子の発光部分 を有する端面に赤外線の励起によつて可視光を発 するけい光体和末と、前記けい光体初末の1~ 10%の樹脂を溶剤によって希釈してなる分散族 を付着させ、仄いで上記発光ダイオート案子を倒 立保持し、その下端に懸垂して付着している上記 分散旗中でけい光半初末が下方に集中広降した状 態のままで、分散媒を乾燥させる事を特徴とする、3 赤外発光性の発光ダイオート第子に赤外線の励起 Kよつて可視光を発するけい光体を塗布する方法。 発明の詳細な説明

本発明は、発光ダイオード素子にけい光体粉末 を堕布する方法に関する。

最近、砒化ガリウム発光ダイオードなどに、不 純物などを入れ近赤外域に発光を持つ様にした、 赤外突光性の発光ダイオード (以下単に発光ダイ オードという)の通常 ウエハーと呼ばれる 発光部 分化、赤外線の励起によつて可視光を発するけい、35 光体(以下単化けい光体という)例えばYF。: Yb.Er. LaF, :Yb.Er 等を塗布し可視発光

性の発光素子を得る事が試みられている。

この種のけい光体は、赤外強度の果果に比例し て可視発光強度が増すため励起密度を高める必要 がある事。 可視発光を取り出すためには、 けい光 5 体層の厚さが問題になる事、それ自体が特殊なけ い光体で極めて高価な事、そして発光ダイオード の発光部分が極めて薄く、大きさも一辺が数百ミ クロンの方形で極めて小さい事などから、少量の けい光体を発光部分に集中し揺近させて途布する 10 必要がある。

この様に、小さな表面上に盛布するという事は、 高年度でパラッキの少いけい光体塗膜を得る事が 必要であるに拘わらす極めて困難な現状にある。

従来、この様な小さな長面に塗布する万法とし 15 ては、刷毛塗りあるいは沈降法などの方法がとら れている。しかし、これらの方法Kより小さい表 面上に発光部分からの赤外線の全反射をさけて効 率良く可視発光を取り出すための、 均一な ドーム 状塗膜を再現性よく得る事は非常に困難であった。 本発明はこれらの難点を解決した面期的な途布

方法である。本発明によれば、液腐及び初体の一 般的な物理的特性を利用する事により、小さな業 子面上に均一なトーム状のけい光体塗膜を再現性 且く形成しうる。

本発明の塗布方法は発光ダイオード素子の発光 部分を有する端面に、けい光体和末および分散媒 を付着させ、次いで上記発光部分が下方に位置す る様に上記発光ダイオード素子を倒立して保持し その下端に懸垂して付着している 上記分数英の核 30 簡中で上記けい光体初末が下方に集中して武降し た状態で、上記分散媒を乾燥させる事を特徴とす ろものである。

以下、図面により本発明の方法を更に具体的に 赤九

第1回 a に示す様に、水平に保たれたダイオー ド1の発光部分を有する遠面の上にけい光体2を 直接所要量乗せる(b)。

その上にパインダーとなる樹脂等を、帝剤 K君 解した分散媒3を、注射器等の細いノズルから通 当量商下する。

商下された液腐は、自由表面に作用する表面後 を包含した状態でトーム状(以下ドームと略称) となる(c参照)。

この様な状態(c)のものを得る手順として上記の 外に先に分散媒を腐下しトームを形成している中 にけい光体を投下する方法、およびけい光体と分 10 敵媒を混合して同時に最速く属下する方法なども 勿論、本発明に包含される

いずれの方法によるにしる重要なことは、分散 せがけい光体和末を包含してドームを形成するこ _である。

以上のようにしてはを得たら、次にこれを自由 表面が下向きになるように半回 伝させる。 寸なわ ち発光ダイオートを倒立して発光部分を有する端 面が下向きで水平になるように保持する。かくて けい光体の比重が分散媒より充分大きいため、ド 20 状化した時全反射しないようにするため、屈折 ーム状に懸垂した分散媒の液質内に包含されたけ い光体等の粉体は、ドーム液質内を沈降し、ドー 4の頂点附近に集まろうとする。かくて被衝内の 粉体分布は山の如くになる。 次いでそのま」(自 由表面を下向きで、水平に保持した状態)これを 25 を満足させる樹脂が適当である。上記諸条件に合

通温乾燥により稀釈器剤は気化していき、けい **体粉末は樹脂と共に徐々にダイオート発光端面 ※P心とする附近K ドーム状になって付着する (· e 参照)。

以上のような方法によって得られたけい光体の 付着 したダイオー ドは通電により 発する 赤外線を 効率良く可視光に変換し、極めて高輝度の緑色発 光を呈す。

それを外部にとり出すためには前述の如くダイオ ードにのせるけい光体量、樹脂と番削からなる分 教媒の組成等により決定する。けいこう体層、密 **着性、形状等が重要な要素となる。**

詳述する。

可視光を最も効率良く取り出すには、ダイオー ドに付着したけい光体層に最適厚さが存在する。 第6図にけい光体層の厚みと、外部に取り出され た発光(相対)輝度の関係の一例を示した。

この例はパインターを用いない場合の例である か、0.2~0.6 森の範囲で最高輝度が得られると いう目安が得られた。次にいくつかの例示樹脂を 力により発光端面上に置かれたけい光体等の粉体 5 パインダーとして用いてダイオードにのせるけい 光体量を変化させた場合のけい光体量と取り出さ れた輝度の関係を第 2図に示した。またけい光体 量と測定されたけい光体層厚の関係を第3図に示

これら両図より可視光を最も効率よく取り出す、 つまり最大輝度を得るためのけい光体の所要量は 各種樹脂の使用に依存せず2から6秒位であり、 けい光体圧厚で 0.1 から 0.5 転の範囲であること が明らかになった。 特に 2 から 4 字の範囲におい 15 て最も明らかになった。 存に2 から 4 90 の範囲に おいて最も再現性良く良好な結果を得る。

ノインターとなる樹脂は

- ① 可視光を取り出すため透明で耐食性の良い事。
- ② 発光ダイオートの屈折率が高いので、トーム 半がなるべく大きい事。
- ③ 加熱乾燥するため熱硬化型で金属に対する接 着力を有する事、
- ④ 発光端面や導線部を腐敗しない事など うものとしては、エポキン樹脂、アクリル樹脂、 シリコーン樹脂、ポリスチレンやポリピニールで。 ルコールなどがある。しかし特に良好なものは、 前三者である。

樹脂の所要量は現在市販のものでも固型もしく は密鉄に溶かしたものなどがあるため特定はしが たいが、とにかくけい光体粒子相互を結合させ、 発光端面附近に付着するに要する最少の量である ことが望さしく、いずれも、けい光体量に対する ダイオードの赤外光を効率良く可視光に変換し、35 固型樹脂分の重量比にして約1~10%が最適で あることが判明した。

樹脂の選択に次いて重要なことは、分散媒を構 成する商剤の種類及びその量の問題である。とに かくけい光体が分散機中を自由に動くこと及び余 これらの関係を解明するため、さらに本発明を 40 分な樹脂分を少なくするため適当な希釈溶媒を入 れることが必要である。

この溶剤は乾燥により気化するため樹脂の様な 特性は必要としない。 例えばトルエン、 アセトン、 キシレンなどが挙げられるが色々な樹脂に合せて、

乾燥時徐々に気化する必要が有る為、比較的赤点 の高い物を主成分とすることが望ましい。 又前記 倒脂を艮く쯈かすという条件も考慮に入れると、 トルエンやキッレンが最適である。 その所要量は 第 4 図と第 5 図に示す如く、市販の樹脂溶液(樹 5 脂固型分50%前後)を使用した場合、いずれも 重量比で10倍から30倍の範囲が良く、輝度及 びけい光体層の形状等の再現性及び取り扱い易き の点から特に20倍附近が最適である。

本発明に於て乾燥温度は、溶剤が徐々に気化し 10 後で樹脂が固まる様に2g階に選ぶのが良く最初 の乾燥段階は室温から100七以下特に70七階 近、後の樹脂硬化はそれぞれ樹脂で当然異るが 200七附近が好ましい。この様にして得られた 図中第4回に示す如く、高蜂度が再現性良く得ら れる。これは厚みにおいても第6図に示された最 適厚附近のけい先体登膜が第3回や第5回の如く 再現性良く得る事ができることによる。 そしてそ の輝度は、刷毛座り、沈降法など公知の塗布方法 20 様な最適な厚みと高輝度を得た。 K比較し1.5~2倍も明るくなる。

従来公知の強布方法では、本契明の様に最少部 分に収率よくおよび再現性よく高価なけい光体を 益布することは全く不可能に近い。

本発明の塗布方法は、けい光体と他の粉末を提 25 合して重布する場合も適用範囲として含むもので ある。また元々可視発光を出す発光ダイオードの 発光端面上に光を拡散する為に光拡散用の粉末を 塗布する場合にもその技術を応用することができ

さらド本発明の途布方法によりけい光体を途布 した上に、けい光体を含まない街脂溶液を塗布す ると、機械的強度の補強と光の利用率の向上のた めに一層効果的である。

以下実施例により本発明を詳述する。 **実施例 1** /

ンリコン樹脂(トーレシリコーン製 SH - 805(固型分50% 溶剤中 **シレン))**

10 gr 40

けい光体

トルエン

4 20

第1図に示すが如く、上記けい光体をダイオー ドの発光端面上に乗せ、上記樹脂及び溶剤の混合

物を注射器の様な趣いノズルから数百号商下して、 ドームを作り、次いで半回転して逆水平にし、 60℃位で、1時間程乾燥器、250℃位で4時 間乾燥する。

かくて第3回および第4回に示される様な最適 な厚みと高輝度を得ることができた。 実施例 2

アクリル樹脂 (三菱レーヨン製タイ ヤナール1034(固型分30%落

剤キシレン))

トルエン

1 5 gr 3 🛶

lgr

けい光体

第1図に示すが如く上記けい尤体を 発光ダイオ 本発明の発光素子は、可視発光母度に於いて第2 15 - ドの発光端面上に乗せ、上記街距及び溶剤の混 合物を圧射器等の細いノメルから数百秒簡下して、 トームを作り、次いで半回転させ、逆水平にし、 6.0℃位で1時間程乾燥し、更K 10.0℃位で4 時間乾燥する事により第3図および第4図に示す 実施例 3

> エポキシ樹脂(シエル化学製エピコ 一ト1004(固型分30%))

lgr.

トルエン

10gr

けい光体

第1図に示す如く、上記けい光体を発光ダイオ ードの発光端面上に乗せ上記樹脂及び密剤の混合 物を住村器のノメルから数百つ箇下してドームを 30 作り、半回転させ、逆水平にし、60℃位で1時 間程乾燥した後、200元位で2時間乾燥。

かくして第3図および第4図に示す様な最適な 厚みと高輝度を得た。

突施例 4

シリコン樹脂 (トーレッリコーン製 SH-808(固型分50%溶剤中 シレン))

lgr

キシレン

15gr

けい光体

4 =9

上記樹脂と帝剤の遠合物を在射器で発光ダイオ 一ト発光端面上に数百岁に腐下しドームを作り、 そのトームの頂点附近 にけい光体を注意深く投入 し、鴻面上に沈降させた後、半回伝させ、逆水平

KL、60で位で1時間更K250で位で2時間 乾燥した。かくて、第3図及び第4図に示される のと同様な良好な厚みと高輝度が得られた。 図面の簡単な説明

第1図は本発明による重布方法を簡単にその順 5 度の関係を示するのである。 序に従い示したものである。第2回は本発明の登 布方法を適用して、赤外発光ダイオートと赤外可 視変換けい光体を塗布した場合の分散媒を一定と したけい光体重量と可視光輝度の関係を示するの である。第3回は第2回に関連する物の、けい光 10 米国特許 3510732(クラス317ー234) 体重量と塗布庫の関係である。第4回は本発明の 並布方法を適用して、赤外発光ダイオードに赤外 可視変換けい光体を並布した場合のけい光体重量 を一定とした分散媒中の樹脂溶液(樹脂固型分を

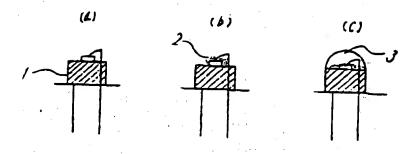
約50%溶剤化溶かした市販の物)対稀积溶剤比 と可視発光輝度の関係を示すものである。第5図 は第4回の樹脂溶液対移収器剤比と塗布厚の関係 を示するのである。第6回はけい光体の厚みと輝

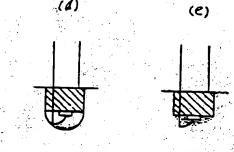
59引用文献

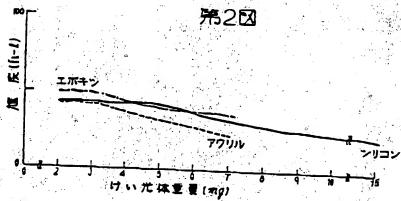
等 公 昭46-9194

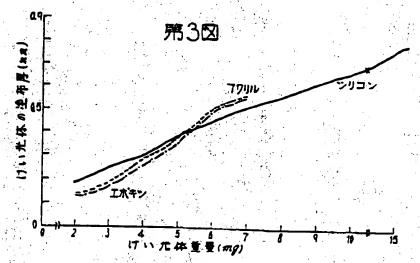
Jownsl of Electrochemical Society 116 [12] P.P.1718-1722 69-

第1図







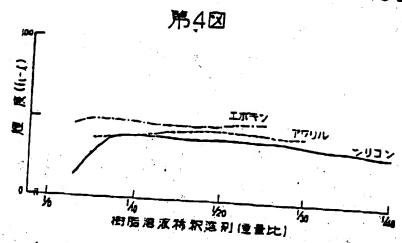


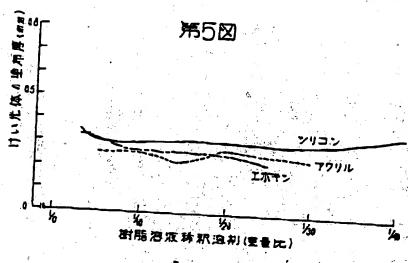
状発

L:

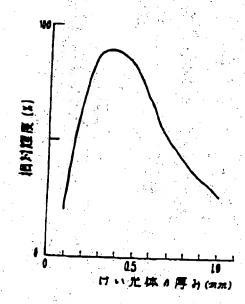
元; 免!

の 存 の 配





第6図



-264

BAD

JP 52-40959

- (54) Method for applying a luminous substance on a light-emitting diode element
- (21) Application No.: Sho 47-78868
- (22) Filing date: August 7, 1972 Publication: Sho 49-37586
- (43) Publication date: April 8, 1974
- (72) Inventors: Akira Hase, 20-41, Dai 2, Kamakura-shi Company dormitory "Ohfuria-Ryo" of Dai Nippon Toryo Co., Ltd. Akio Toedanai, 5-205, Tsurugadai 4, Chiqasaki
- (71) Applicant: Dai Nippon Toryo Co., Ltd., 1-124, Nishikujo 6, Konohana-ku, Osaka
- (74) Representative: Patent Attorney Shigeru Yamamoto, plus one colleague

(57) Claim

1. Method for applying a luminous substance that emits visible light when stimulated by infrared radiation on an infrared light-emitting diode element, characterized in that

a luminous substance powder that emits visible light when stimulated by infrared radiation and a dispersion comprising a resin [in an amount] of 1 to 10% based on [the amount of] said luminous substance powder and diluted in a solvent are adhered to that end face of an infrared light-emitting diode element having a light-emitting portion.

then said light-emitting diode element is held in an upside down position, and said dispersion is dried in the condition where said luminous substance powder concentrates in said dispersion suspended from the bottom end of said light-emitting diode element, by sedimenting in a downward direction.

Detailed Explanation of the Invention

The present invention relates to a method for applying a luminous substance powder on a light-emitting diode element.

Recently it is being attempted to obtain light-emitting elements capable of emitting visible light by applying a luminous substance that emits visible light when stimulated by IR radiation (in the following simply referred to as "luminous substance"), such as YF3: Yb · Er or LaF3: Yb · Er, to a light-emitting portion of an IR light emitting diode (in the following simply referred to as "LED"), generally referred to as a wafer, that is caused to have a light emission in the near infrared range by introducing impurities etc. into a gallium arsenide type light-emitting diode or the like.

With this kind of luminous substance, the luminous intensity of visible light increases in proportion to a power of the infrared luminous intensity, so that it is necessary to increase the stimulation density; in order to obtain an output of visible light, the thickness of the luminous substance layer is a problem, which in itself is a specialized luminous substance and extremely costly; moreover the light-emitting portion of the LED is extremely thin and furthermore extremely small, having a square shape with a side length of several hundred microns; it is accordingly necessary to coat the light-emitting portion by applying a small amount of luminous substance on it in a concentrated manner.

Therefore, although it is necessary to obtain a luminous substance film with high luminance and little scattering of luminance, coating application on a small surface is thus extremely difficult.

Conventionally, brush application or sedimentation methods have been utilized for the coating application on such small surfaces. However by such methods it was very difficult to produce with good reproducibility the homogeneous domeshaped coating film on a small surface for a highly efficient output of visible light while avoiding full reflection of the infrared radiation from the light-emitting portion.

The present invention is an innovativ application method that solves the mentioned problems. In accordance with the present invention, uniformly domeshaped luminous substance coating films are formed on small element surfaces with good reproducibility by making use of the general physical properties of the droplet of liquid and of the powder.

The application method according to the invention is characterized in that a luminous substance powder and a dispersion are adhered to that end face of an infrared light-emitting diode element having a light-emitting portion, then the light-emitting diode element is turned upside down so that the light-emitting portion is positioned at the bottom, and the dispersion is dried in the condition where the luminous substance powder concentrates in the liquid drop of dispersion suspended from the bottom end of the light-emitting diode element by sedimenting in a downward direction.

In the following, the method of the present invention is explained more specifically by referring to the figures.

Onto the end face of a diode 1 having the light-emitting portion, held horizontally in accordance with the representation of Fig. 1a, a required amount of luminous substance 2 is placed directly (b).

An appropriate amount of dispersion 3 of a resin or the like as a binder, dissolved in solvent, is placed on top of this as a droplet through the narrow nozzle of a syringe or the like.

The applied drop of liquid, while enclosing the powder such as the luminous substance placed on the light-emitting end face, assumes a dome-shape (hereinafter referred to as "dome") due to the surface tension acting on its free surface (cf. (c)).

As a measure for obtaining this condition (c) apart from the above mentioned one, there are, of course, other methods, such as to introduce the luminous substance into a dome formed by applying a drop of dispersion in advance, or

to mix the luminous substance and the dispersion and rapidly apply them jointly as a drop, however these methods ar encompassed by the present invention.

Independently of the method used, the important point is that the dispersion encloses the luminous substance powder and forms a dome.

Once the above mentioned state (c) has been obtained, the whole is rotated half a turn to make the free surface face downward. I.e., the LED is turned upside down and held horizontal, with the end face having the light-emitting portion facing downward. As the luminous substance has a far greater specific weight than the dispersion, a powder of luminous substance etc. that is enclosed in the droplet of dispersion suspended in a dome shape will be sedimented inside the dome-shaped liquid droplet and gather near the apex of the dome. The distribution of the powder inside the liquid droplet will thus resemble the one in (d). Subsequently the whole is dried at a suitable temperature while in this condition (i.e., held horizontal, with the free surface facing downward).

By drying at a suitable temperature, the diluting solvent gradually evaporates so that the luminous substance powder together with the resin adheres in a dome shape centered on the light-emitting end face of the diode (cf. (e)).

The diode obtained in accordance with the above method and having a luminous substance adhered to it converts the infrared radiation emitted as a result of current passing through it into visible radiation, to thereby develop a green light of very high luminance.

Whether the infrared light of the diode is converted into visible light at a good efficiency and extracted to the outside, is determined in accordance with the above description by the amount of luminous substance placed on the diode, the composition of the dispersion comprising resin and solvent, etc.. Luminous substance layer, adhesion capability, shape etc. are importance factors.

The invention shall now be described further so as to elucidate the relevance of these relationships.

For obtaining maximum efficient output of visible light, there exists an optimum thickness of the luminous substance layer adhered to the diode. Fig. 6 shows an example for the relationship between the luminous substance layer thickness and the possible output of (relative) emission intensity.

In this example no binder was employed, but it provided the indication that a maximum luminance is obtained in a range of 0.2 - 0.6 mm. Fig. 2 shows the relationship between the luminous substance quantity and the possible luminous output while changing the amount of luminous substance applied on the diode by using several exemplary resins as a binder. Fig. 3 shows the relationship between the luminous substance quantity and the measured luminous substance layer thickness.

From the two figures it could be seen that the amount of luminous substance required for maximum efficiency output of visible light, i.e. for attaining maximum luminance, independently of the kind of resin used is about 2 - 6 mg, with a luminous substance thickness in the range of 0.1 - 0.5 mm. It also became clear that the best results with the best reproducibility were obtained the range of 2 - 4 mg.

Suitable binders are those resins that are capable of satisfying the following demands:

- High transparency for outputting visible light, and good weathering resistance;
- a maximum possible refraction coefficient to avoid full reflection due to the high refraction coefficient of dome-shaped LEDs;
- heat settability for drying in heat, and metal bonding capability:
- no corrosion to light-emitting end face and lead parts.

These conditions are satisfied by epoxy resin, acrylic resin, silicone resin, polystyrene and polyvinyl alcohol, with the former three being particularly preferred.

It is not easy to determine the required amount of resin even with currently marketed resins, whether solid or in solution in a solvent; it was, however, found that in any case the minimum quantity required for binding the luminous

substance particles to each other and bonding them in the vicinity of the lightemitting end face is desirable, and that for each resin a solid amount of approx 1 - 10% based on the weight of the luminous substance is most suitable.

Having selected a resin, there is the problem of kind and quantity of the solvent for forming the dispersion. In any case the addition of diluting solvent should be adequate for allowing the luminous substance to be freely movable in the dispersion, and reducing an excess resin content.

The solvent is evaporated by drying and thus needs not satisfy the properties demanded of the resins. Toluene, acetone, xylene may be named as examples for suitable solvents; however the solvent should furthermore include a main component having a comparatively high boiling point because it should gradually evaporate during drying in harmony with a respectively used resin. When furthermore considering the condition of well dissolving the above mentioned resins, toluene and xylene are suited best. As is shown in Figs. 4 and 5 with regard to their required quantities, when using a commercially available resin solution (solid proportion: approx. 50%) they are all preferably used in a quantity in the range of 10 - 30 times the weight of the resin, but in terms of luminance and reproducibility of the shape of the luminous substance layer as well as easy handling, 20 times the weight of the resin is suited best.

In accordance with the invention, the drying temperature is suitably selected for two stages such that at first the solvent gradually evaporates, and then the resin cures. For the first drying step the temperature preferably is from room temperature to 100°C, particularly around 70°C, and for the later curing step a temperature of approx. 200°C depending upon each respective resin is preferred. As is shown in Figs. 2 and 4 with regard to the intensity of visible light emission, the light-emitting element of the invention obtained in this way has high luminance with good reproducibility. The reason for this is that the thickness of the luminous substance coating film, as well, may be obtained nor the optimum thickness, as is shown in Fig. 6, at good reproducibility, as is shown in Figs. 3 and 5. In accordance with the method of the invention, luminance is moreover 1.5 - 2 times as high as with those obtained in accordance with the known methods such as brush application, sedimentation etc. methods.

In accordance with the previously known application methods it is hardly possible to efficiently apply a costly luminous substance on a very small part with good yield and good reproducibility as in accordance with the method of the invention.

The application method of the present invention furthermore encompasses the application range of applying a luminous substance in a mixture with other powders. The technique according to the invention may also be used to apply a powder having the purpose of scattering light on the light-emitting end face of an LED that emits visible light.

Application of a resin solution without luminous substance on an applied luminous substance in accordance with the application method of the invention moreover has the effect of further improved mechanical strength and utilization factor.

In the following, the invention shall be explained in detail by way of examples.

Example 1

Silicone resin (SH-805 by Toray Silicone		
(50% solid in xylene as a solvent))		1
Toluene		1 g
	ě.	10 a
Luminous substance		
		4 mg

As is shown in Fig. 1, the above mentioned luminous substance was placed on the light-emitting end face of a diode, and several hundred 100 mg of a mixture of the mentioned resin and solvent was deposited as a droplet through a narrow nozzle such as of a syringe, so as to form a dome; then the whole was rotated half a turn into a reverse horizontal position, dried for about 1 h at approx. 60°C, and dried further for about 4 h at approx. 250°C.

In this way, the optimum thickness and high luminance in accordance with the representation of Figs. 3 and 4 could be obtained.

Example 2

Acrylic resin (Dianal 1034 by Mitsubishi Rayon	
(30% solid in xylene as a solvent))	1 α
Toluene	15 g
Luminous substance	3 mg

As is shown in Fig. 1, the above mentioned luminous substance was placed on the light-emitting end face of a diode, and several hundred 100 mg of a mixture of the mentioned resin and solvent was deposited as a droplet through a narrow nozzle such as of a syringe, so as to form a dome; then the whole was rotated half a turn into a reverse horizontal position, dried for about 1 h at approx. 60°C, and dried further for about 4 h at approx. 100°C; hereby the optimum thickness and high luminance in accordance with the representation of Figs. 3 and 4 were obtained.

Example 3

Epoxy resin (Epicoat 100	4 by Shell (Chemical		
(30% solid))				1 a
Toluene			9	, 3
Luminous substance		1 £	4	10 g 3 mg

As is shown in Fig. 1, the above mentioned luminous substance was placed on the light-emitting end face of a diode, and several hundred 100 mg of a mixture of the mentioned resin and solvent was deposited as a droplet through a narrow nozzle such as of a syringe, so as to form a dome; then the whole was rotated half a turn into a reverse horizontal position, dried for about 1 h at approx. 60°C, then dried for about 2 h at approx. 200°C.

In this way, the optimum thickness and high luminance in accordance with the representation of Figs. 3 and 4 could be obtained.

Exampl 4

Silicone resin (SH-808 by Toray Silic	соле	
(50% solid in xylene as a solvent))	e e	1.0
Xylene		1 g
Luminous substance	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15 g
Equilions annatauce		4 mg

The mixture of several 100 milligrams of the above mentioned resin and the above mentioned solvent was deposited on the light-emitting end face of a diode as a droplet through a syringe, so as to form a dome. After that a luminous substance was introduced by injecting it deeply near the apex of the dome and made to sediment on the end face. Then the whole was rotated half a turn into a reverse horizontal position, dried for about 1 h at approx. 60°C and further for about 2 h at approx. 250°C.

Short Explanation of the Figures

Fig. 1 is a simplified representation of the application method of the invention in the order of working. Fig. 2 shows the relationship between the luminous substance weight and the luminance of visible light with a defined dispersion for an infrared-emitting diode on which a luminous substance for converting IR into visible radiation is applied in accordance with the application method of the present invention. Fig. 3 relates to Fig. 2 and shows the relationship between the luminous substance weight and the coating thickness. Fig.4 shows the relationship between the resin solution (commercial product with approx. 50% solid resin dissolved in the solvent) / diluting solvent ratio in the dispersion and the luminance of visible radiation with a defined luminous substance weight for an infrared-emitting diode on which a luminous substance for converting IR into visible radiation is applied in accordance with the application method of the present invention. Fig. 5 shows the relationship between resin solution / diluting solvent ratio specified in Fig. 4 and coating thickness. Fig. 6 shows the relationship between thickness of the luminous substance and luminance.

(56) Cit d literature

Published patent application Sho 46(1971)-9194
US patent specification No. 3510732 (Classification 317-234)
Journal of Electrochemical Society] 116 [12], pp. 1718-1722, 69-12

Fig. 1

(ord.)

Fig. 2 **Epoxy** Acrylic Silicone (absc.) Luminous substance weight (mg) (ord.) Luminance (fL) Fig.3 Ероху Acrylic Silicone (absc.) Luminous substance weight (mg) (ord.) Thickness of applied luminous substance (mm) Fig. 4 **Epoxy** Acrylic Silicone (absc.) Resin solution/diluting solvent (wt. ratio) (ord.) Luminance (fL) Fig. 5 **Epoxy** Acrylic Silicone Resin solution/diluting solvent (wt. ratio) (absc.) Thickness of applied luminous substance (mm) (ord.) Fig. 6 Luminous substance thickness (mm) (absc.)

Relative luminance (%)